



# 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月30日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社  
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 東 哲郎  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 (氏名) 原田 芳輝  
 四半期報告書提出予定日 平成25年8月7日  
 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

上場取引所 東

TEL 03-5561-7000

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	103,452	△22.9	△9,646	—	△9,898	—	△2,976	—
25年3月期第1四半期	134,179	△12.4	9,283	△59.8	11,248	△52.6	5,720	△65.6

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 2,092百万円 (△21.0%) 25年3月期第1四半期 2,649百万円 (△84.2%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第1四半期	△16.61	—
25年3月期第1四半期	31.93	31.88

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第1四半期	778,631	600,695	75.6
25年3月期	775,527	605,127	76.5

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 588,605百万円 25年3月期 593,032百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	25.00	—	26.00	51.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	25.00	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。  
 平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

## 3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	252,000	△5.5	△6,500	—	△1,000	—	△5.58
通期	562,000	13.0	18,000	43.4	13,000	113.9	72.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期1Q	180,610,911 株	25年3月期	180,610,911 株
26年3月期1Q	1,423,288 株	25年3月期	1,424,203 株
26年3月期1Q	179,187,348 株	25年3月期1Q	179,169,890 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成25年7月30日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間については、米国及び日本での景気持ち直しの動きがありましたが、中国をはじめとする新興国経済の成長率鈍化、欧州における景気下げ止まりの兆しなど、総じて世界経済の回復は弱い動きとなりました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、テレビやパソコンなどの製品需要は依然厳しい状況が続くものの、新興国におけるスマートフォンの需要拡大を中心に、タブレットPCを含めたモバイル端末は堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループの受注は回復基調にあります。出荷及び売上までのリードタイムに一定期間を要するため、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,034億5千2百万円(前年同期比22.9%減)、営業損失96億4千6百万円(前年同期は92億8千3百万円の営業利益)、経常損失98億9千8百万円(前年同期は112億4千8百万円の経常利益)、また、四半期純損失は29億7千6百万円(前年同期は57億2千万円の四半期純利益)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、当第1四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に基づき報告セグメントを変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

#### ① 半導体製造装置

スマートフォンやタブレットPCの好調を背景として、DRAMやNANDフラッシュメモリの需給は引き締まってきており、メモリーメーカーにおける増産投資再開の動きが出始めておりますが、当第1四半期連結累計期間の売上にこれらが大きく貢献するまでに至らなかったため、外部顧客に対する売上高は749億4千4百万円(前年同期比31.1%減)となりました。

#### ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

モバイル端末向け中小型液晶パネルは比較的堅調に推移しており、FPD製造装置市場は前年度の大幅な調整局面から徐々に回復する傾向を見せております。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、49億6百万円(前年同期比3.5%増)となりました。

#### ③ PV(太陽光パネル)製造装置

薄膜シリコン太陽光パネルの高い変換効率達成に向け鋭意開発の加速と、サンベルト地域等の顧客開拓に努めましたが、当第1四半期連結累計期間は新規受注に伴う売上貢献がなかったため、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、20億6千2百万円(前年同期は2千9百万円の売上高)となりました。

#### ④ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、自動車、産業機器関連の需要が緩やかに回復し、情報通信機器関連事業においては、通信関連事業の設備投資が回復基調を示しました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、214億2千6百万円(前年同期比4.0%増)となりました。

#### ⑤ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億1千1百万円(前年同期比10.0%増)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期	前期				当期第1Q
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	497,299	134,179	132,421	91,910	138,788	103,452
半導体製造装置	392,026	108,703	105,963	68,056	109,303	74,944
日本	40,278	10,032	10,186	6,349	13,709	11,648
米国	117,092	26,629	29,152	28,879	32,431	15,101
欧州	38,701	10,457	12,944	7,673	7,626	5,666
韓国	57,510	24,214	14,463	5,759	13,074	11,184
台湾	105,386	29,338	29,456	15,238	31,352	24,509
中国	19,951	5,666	6,196	2,153	5,935	4,711
東南アジア他	13,104	2,363	3,563	2,003	5,174	2,123
F P D製造装置	20,077	4,740	4,425	4,681	6,229	4,906
P V製造装置	83	29	34	1	18	2,062
電子部品・情報通信機器	84,664	20,605	21,859	19,105	23,093	21,426
その他	448	101	137	66	142	111
営業利益(△損失)	12,548	9,283	2,918	△6,865	7,211	△9,646
経常利益(△損失)	16,696	11,248	4,211	△6,654	7,891	△9,898
四半期(当期)純利益(△損失)	6,076	5,720	370	△7,026	7,012	△2,976

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## 【生産及び受注の実績】

## 1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期通期	前期				当期第1Q
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
半導体製造装置	343,875	96,681	88,294	68,894	90,005	79,358
F P D製造装置	16,998	2,098	4,467	3,026	7,406	6,037
P V製造装置	71	23	44	3	—	2,146
合計	360,945	98,803	92,806	71,924	97,411	87,542

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期	前期				当期第1Q
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
半導体製造装置	342,547	76,029	66,928	91,324	108,265	97,708
F P D製造装置	21,882	2,799	8,051	3,668	7,362	14,491
P V製造装置	83	29	34	4	14	1,185
電子部品・情報通信機器	85,666	22,631	20,658	18,548	23,827	23,872
その他	448	101	137	66	142	111
合計	450,627	101,590	95,810	113,612	139,612	137,369

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3. 受注実績 (受注残高)

(単位: 百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	157,737	118,702	142,654	141,616	164,587
F P D製造装置	12,260	15,885	14,873	16,005	25,584
P V製造装置	0	—	8,425	8,421	7,618
電子部品・情報通信機器	15,809	14,608	14,051	14,785	17,231
その他	—	—	—	—	—
合 計	185,807	149,196	180,004	180,829	215,022

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ28億8千6百万円減少し、5,186億1千4百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少171億8千万円、未収消費税等の減少110億7千5百万円、たな卸資産の増加157億5千6百万円、現金及び預金の増加66億3百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から8億2千3百万円増加し、1,365億2千1百万円となりました。

無形固定資産は、のれんの増加13億1千万円などにより、前連結会計年度末から27億5千9百万円増加し、626億7千7百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から24億7百万円増加し、608億1千8百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から31億3百万円増加し、7,786億3千1百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ64億4千1百万円増加し、1,131億1千1百万円となりました。主として、前受金の増加82億6千7百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ10億9千4百万円増加し、648億2千4百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ44億3千2百万円減少し、6,006億9千5百万円となりました。主として、四半期純損失29億7千6百万円を計上したことによる減少、連結子会社の決算期変更等による利益剰余金の減少32億4千4百万円、前期の期末配当46億5千8百万円の実施による減少、円安の影響等による為替換算調整勘定の増加61億4千2百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は75.6%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ70億5千3百万円増加し、923億6千7百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,371億8千4百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ105億7千7百万円減少し、2,295億5千2百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ372億3千4百万円減少の13億7千万円の支出となりました。主な要因につきましては、未収消費税等の減少111億3千5百万円、前受金の増加76億6千9百万円、減価償却費63億7百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、税金等調整前四半期純損失98億4千5百万円、たな卸資産の増加157億5千1百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入176億5千1百万円、有形固定資産の取得による支出32億1千1百万円により、前年同期の460億6千5百万円の支出に対し132億7百万円の収入となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払46億5千8百万円により、前年同期の48億8千9百万円に対し14億4千2百万円となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,864	△1,370
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	11,231	△9,845
減価償却費	5,585	6,307
売上債権の増減額(△は増加)	26,010	5,111
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,112	△15,751
仕入債務の増減額(△は減少)	△11,425	715
その他	△650	12,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,065	13,207
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△21,000	17,651
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出	△15,830	—
その他(固定資産の取得等)	△9,234	△4,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,889	△1,442
現金及び現金同等物に係る換算差額	△835	△2,134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△15,926	8,260
現金及び現金同等物の期首残高	158,776	85,313
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	△1,206
現金及び現金同等物の四半期末残高	142,849	92,367
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	252,692	229,552

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

主力の半導体製造装置事業の売上につきましては増加基調にあることから、上半期において増加し、下半期は当初見通しを据え置き、通期で増加となる見込みです。また、PV製造装置事業においては、当初計画していた顧客の投資決定時期が遅れ気味であることから、上半期、下半期ともに売上見込みを引き下げることとしました。以上の影響から、利益面では上半期の全社利益は増額となり、下半期は若干の減益となりますが、通期全体では据え置きとなります。これにより、平成25年4月30日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を次のとおり修正いたします。

## 平成26年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通 期
売上高	2,520億円 (前年同期比 5.5%減)	5,620億円 (前年同期比 13.0%増)
半導体製造装置	1,960億円 (前年同期比 8.7%減)	4,360億円 (前年同期比 11.2%増)
F P D 製造装置	100億円 (前年同期比 9.1%増)	260億円 (前年同期比 29.5%増)
P V 製造装置	40億円	110億円
電子部品・情報通信機器	420億円 (前年同期比 1.1%減)	890億円 (前年同期比 5.1%増)
営業利益(△損失)	△65億円	180億円 (前年同期比 43.4%増)
当期(四半期)純利益(△損失)	△10億円	130億円 (前年同期比113.9%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

## (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった一部の在外子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、当第1四半期連結会計期間より、決算日を3月31日に変更又は連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更しております。

これらの変更により、当第1四半期連結会計期間は、上記連結子会社の平成25年4月1日から平成25年6月30日までの3ヶ月間を連結しております。なお、平成25年1月1日から平成25年3月31日までの損益については、利益剰余金の増減として調整しております。

## (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

## (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。



3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,632	56,235
受取手形及び売掛金	100,500	95,845
有価証券	190,497	173,316
商品及び製品	87,397	100,967
仕掛品	33,402	35,896
原材料及び貯蔵品	14,898	14,589
その他	46,351	42,223
貸倒引当金	△1,179	△461
流動資産合計	521,501	518,614
固定資産		
有形固定資産	135,697	136,521
無形固定資産		
のれん	38,372	39,683
その他	21,545	22,993
無形固定資産合計	59,918	62,677
投資その他の資産		
その他	60,522	62,917
貸倒引当金	△2,112	△2,099
投資その他の資産合計	58,410	60,818
固定資産合計	254,026	260,017
資産合計	775,527	778,631
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	36,261	37,686
製品保証引当金	8,344	8,360
その他の引当金	6,908	3,777
その他	55,155	63,287
流動負債合計	106,670	113,111
固定負債		
退職給付引当金	56,643	57,463
その他の引当金	580	573
その他	6,505	6,788
固定負債合計	63,730	64,824
負債合計	170,400	177,936
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	467,920	457,038
自己株式	△9,588	△9,581
株主資本合計	591,315	580,441
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,214	4,497
繰延ヘッジ損益	△14	7
為替換算調整勘定	△2,483	3,658
その他の包括利益累計額合計	1,716	8,164
新株予約権	1,374	1,464
少数株主持分	10,720	10,624
純資産合計	605,127	600,695
負債純資産合計	775,527	778,631

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
四半期連結損益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	134,179	103,452
売上原価	90,067	73,535
売上総利益	44,111	29,916
販売費及び一般管理費		
研究開発費	17,928	17,993
その他	16,899	21,570
販売費及び一般管理費合計	34,827	39,563
営業利益又は営業損失(△)	9,283	△9,646
営業外収益		
受取利息	289	326
受取配当金	184	237
為替差益	513	—
その他	1,042	373
営業外収益合計	2,029	937
営業外費用		
為替差損	—	1,096
支払補償費	14	—
その他	50	91
営業外費用合計	64	1,188
経常利益又は経常損失(△)	11,248	△9,898
特別利益		
固定資産売却益	1	74
特別利益合計	1	74
特別損失		
固定資産除売却損	17	21
特別損失合計	17	21
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	11,231	△9,845
法人税等	3,255	△6,876
過年度法人税等	2,194	—
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	5,782	△2,969
少数株主利益	62	6
四半期純利益又は四半期純損失(△)	5,720	△2,976

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 (△)	5,782	△2,969
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,000	288
繰延ヘッジ損益	70	53
為替換算調整勘定	△2,202	4,719
その他の包括利益合計	△3,132	5,061
四半期包括利益	2,649	2,092
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,563	2,016
少数株主に係る四半期包括利益	86	75

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## ① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」、「PV(太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結損益 計算書計上額 (注)3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置	PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	74,954	4,906	2,062	21,620	2,818	106,362	△2,910	103,452
セグメント利益 又は損失(△)	2,279	△307	△2,571	△21	379	△240	△9,605	△9,845

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△9,605百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△4,768百万円であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントの変更等に関する事項

TEL Solar Holding AGを連結子会社としたことに伴い、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「FPD/PV製造装置」から「FPD製造装置」及び「PV製造装置」に変更しております。

## ④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。